

特点:

- 低插入损耗：典型值 2dB
- 高隔离度：最小值 40dB
- 高输入-1 dB 压缩点： 20dBm
- SMT 封装
- 尺寸：4.0×4.0×1.6mm³
- 执行标准为 GJB8481-2015

性能参数（25℃）:

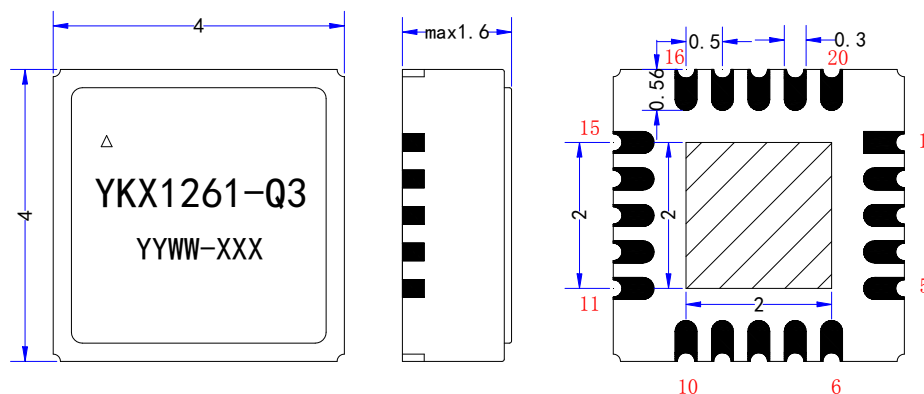
参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注
			MIN	TYP	MAX		
频率范围	f	V _{EE} =-5V f=2~8GHz 控制电平 0/+5V	2		8	GHz	
插入损耗	Li			2	3	dB	全温
输入驻波比	VSWR _i			1.5:1	2.5:1		全温
输出驻波比	VSWR _o			1.5:1	2.5:1		全温
隔离度	ISO		40			dB	
输入 P ₋₁	P ₋₁		20			dBm	
电源电压	V _{EE}		-4.75	-5	-5.25	V	
电流	I _{EE}			1		mA	
工作温度	T		-55		+85	℃	
质量	m				1.0	g	

极限参数表:

参数名称	极限值	单位	参数名称	极限值	单位
电源电压	-5.5	V	输入射频功率	30.0	dBm
控制电压	低	0~0.2	储存温度	-55~+125	℃
	高	3~6			

封装外形图:

单位: mm 公差: ±0.2mm



字符标志：

YKX1261-Q3	产品型号
△	1 脚
YYWW	批次号
XXX	序列号

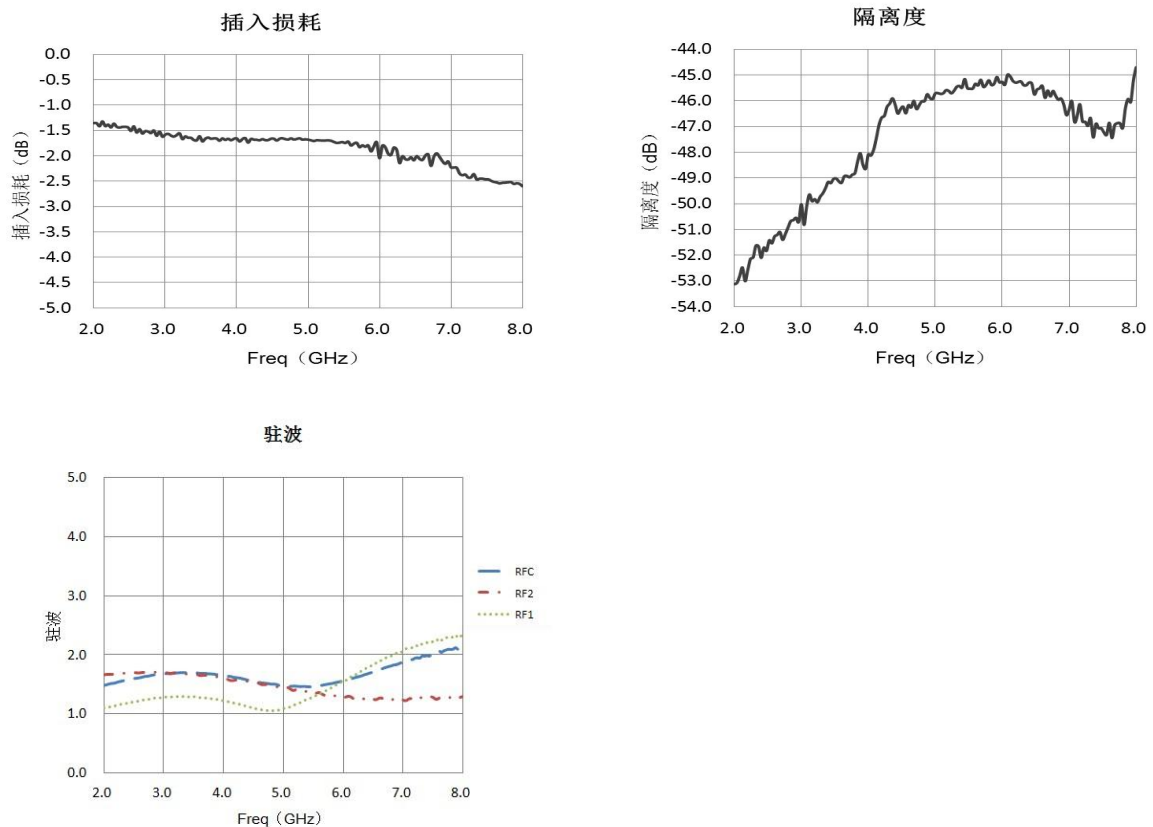
引脚定义：

引脚编号	符号	引脚定义
3	RF1	射频输出端口 1, DC 耦合
13	RF2	射频输出端口 2, DC 耦合
18	RFC	射频输入端口, DC 耦合
8	V _{EE}	电源-5V
10	Ctrl	控制端
1/5/6/11/15/16/20	GND	接地
其它引脚	NC	

真值表：(0=0V, 1=+5V)

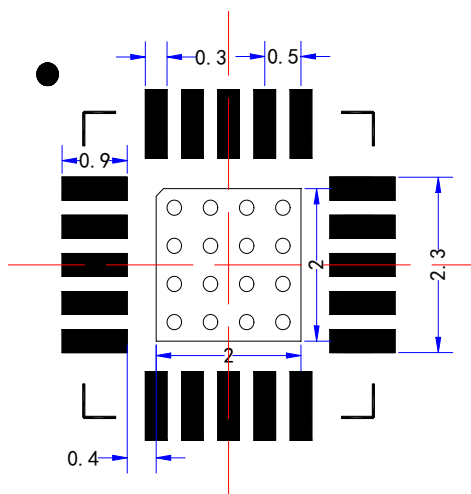
Ctrl	RFC-RF1	RFC-RF2
0	导通	关断
1	关断	导通

测试曲线：



推荐焊盘：

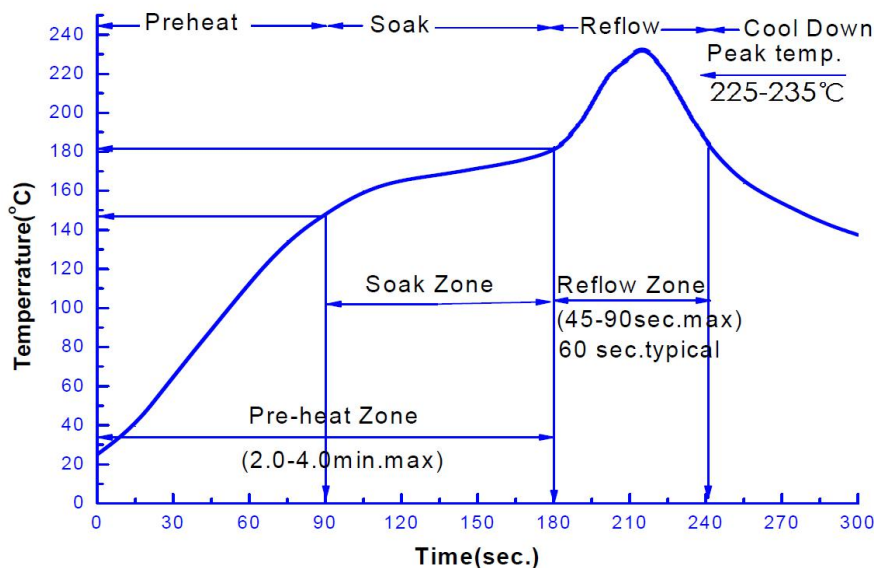
单位：mm



注：接地孔需要尽量多，保证良好的接地效果

产品使用注意事项：

- 1.产品属于静电敏感器件，耐静电能力 $\leq 250V$ ，产品在运输、装配使用过程中请注意静电防护；
- 2.产品使用时请保证接地良好（GND 引脚和底部金属化区域），为了保证连接良好，底部引脚焊好之后，需对侧面引脚进行补焊；
- 3.产品推荐采用 SMT 工艺贴片使用，采用 Sn63/Pb37 锡膏，熔点 183℃回流焊接，回流温度推荐曲线。



此图为推荐回流温度曲线，因基板及回流焊设备性能不同而有所差异。请依据使用的基板与回流设备确认实际温度曲线，实测回流基板温度不得超过 235℃。

- 4.如特殊情况需采用手工焊接，烙铁温度 350℃，焊接时间不超过 3 秒；回流及手工焊接次数不大于 3 次。
5. 产品在存储时需采用防静电托盘或防静电袋进行密封包装，存放条件：温度 10~35℃，湿度 35~65%RH；对于需长期储存（超过半年）产品尽量在充氮干燥环境下存放。
6. 客户在产品应用时应结合实际环境考虑是否对产品进行防护处理。对有盐雾防腐等要求的环境，客户在对产品焊接及清洗完成后，应对宇熙产品进行三防喷涂处理，以提高产品耐环境适应性能力。